



ホンダセイキ

# 本田精機 株式会社

市場・技術研究会

半導体製造装置  
太陽電池製造装置

医療・健康

エネルギーデバイス

航空機

「1mm角サイズの部品加工から精密機械・実験装置等の設計・製造・据付調整まで!」

企画・研究

開発・設計

試作/小ロット

生産

資材調達

組立

検査・評価

## 製品・技術の特徴

### ■技術の特徴

- 生産設備機械で一貫した取組み  
(お客様のご要望で、設計から製作調整設置まで対応)
- 積極的な新技術、新製品の研究開発(産学連携)

### ■主要製品

#### 【設計】

- 自動機設計
- 電機設計
- 油圧空圧ユニット設計

#### 【部品加工】

- 機械加工全般
- 三次元5軸加工
- 金属
- 非鉄金属
- プラスチック
- ゴム
- ロール鏡面加工

#### 【溶接/板金加工】

- 鉄、アルミ、ステンレス
- プラスチックの溶接
- レーザー切断加工

#### 【表面処理】

- 硬質クロームメッキ
- 梨地処理
- 溶射加工

#### 【組立/調整】

- 自動機組立
- 調整、メンテナンス

#### 【据付/解体】

- レベル出し、解体、撤去



マシニングセンタ門型5面加工機



大径ロールの旋盤加工



円筒研削加工



鏡面加工



加工工場

## お問い合わせ先

【担当】  
代表取締役 本田典明

【TEL】  
022-284-3077

【FAX】  
022-284-9078

【E-mail】  
honda@hondaseiki.co.jp

## 企業情報

【URL】  
<http://www.hondaseiki.co.jp/>

【所在地】  
〒983-0034  
仙台市宮城野区扇町4-6-7  
tel 022-284-3077  
fax 022-284-9078

【代表者】  
代表取締役 本田典明

【資本金】  
1,500万円

【従業員】  
44人

【沿革(設立)】  
1961年 創業  
1989年 設立

【面積(敷地工場)】  
敷地 16,214㎡  
建物 7,155㎡

## 事業の概要

(事業の特徴、生産品目/生産高(ロット)/売上高、取引先、設備)

### ■事業内容

- 精密機械装置、及び部品の製造、販売  
(設計、部品加工、板金溶接、表面処理、組立調整)

### ■売上高

2008年 17億7,230万円  
2007年 18億4,520万円  
2006年 15億2,921万円

### ■生産設備

名 称	数 力	台数
門型マシニングセンタ ユニバーサルヘッド	X-5,000 Y-3,250 Z-1,950	1台
門型マシニングセンタ 5面加工機	X-6,000 Y-2,000 Z-1,100	1台
門型マシニングセンタ 簡易5面加工機	X-3,000 Y-2,000 Z-1,100	2台
門型マシニングセンタ	X-3,000 Y-1,500 Z-1,100、他	2台
門型NCフライス	X-3,000 Y-1,500 Z-1,100、他	3台
立型マシニングセンタ	X-2,000 Y- 850 Z- 840、他	7台
汎用旋盤	φ1,000×3,000 φ800×4,000、他	26台
円筒研削盤	φ800×4,000、他	10台
鏡面加工機	φ800×5,000、他	8台
NC平面研削盤	X-1,500 Y- 660 Z- 400、他	3台
3次元レーザーカット切断機	4Kw 1,250×2,500、他	2台
溶接・板金設備		1式
硬質クロームメッキ設備	1,000×3,000×1,800、他	2式
塗装設備	2,000×3,000×2,000	1式

## 【社屋写真】



認可・認証 (ISO対応 許認可等)

鋳造  
ダイカスト鍛造  
プレス

材料

機械加工

樹脂加工  
樹脂成形工具  
刃具表面処理  
表面加工  
熱処理電子部品  
実装金型  
治工具装置  
自動機研究  
開発ソフト  
システム

その他